

AREC・Fiiプラザ 第156回リレー講演会

電気・通信・ITC分野

■日時：平成26年5月22日（木） 15:00~18:00 ※終了後、交流会開催

■場所：AREC [上田市産学官連携支援施設] 4階

(上田市常田3-15-1 信州大学繊維学部内 Tel: 0268-21-4377)

講演1

15:00~16:00

演題『抵抗器への要求と開発動向』

講師：KOA株式会社ものづくりイニシアティブ技創りセンター
企画応用グループ/KPS-3推進グループ 赤羽 秀樹 氏

概要 近年の小型情報端末は、多機能化に伴い電子部品の搭載数が増加傾向にあり、更なる部品実装エリアの確保の要求があります。新しい高密度実装技術として、「部品内蔵基板」が注目されており、そこに使用される基板内蔵用チップ抵抗器が開発されています。また、SiC半導体の実用化により、高耐熱パワーモジュールなどの研究開発が進められており、そこでは非常に高温の環境下でも使用できる高耐熱チップ抵抗器が求められています。このような抵抗器への要求に対する抵抗器の開発動向をご紹介します。

講演2

16:00~17:00

演題『ICT活用によるソーシャルイノベーションへの取組み』

講師：富士通株式会社 イノベーションビジネス本部
シニアディレクター 若林 毅 氏

概要 総務省は社会が抱える様々な課題を、ICT(情報通信技術)を活用して解決する為、様々な政策を推進しています。ソレキア殿に製品を供給する富士通株式会社も、既存のICTに加え、クラウド、ビッグデータ、AR(仮想現実)、M2M等のテクノロジーを活用し、豊で安心・快適、便利に暮らせる社会の実現に向け様々な新しいサービスを提供しています。その中からクラウドを活用した「高齢者ケア」、「動物医療」、「食・農業」向けのサービスの事例をご紹介します。

休憩

講演3

17:00~18:00

演題『有機EL：材料とデバイスの動向』

講師：信州大学繊維学部 機能高分子学課程 教授 市川 結 氏

概要 スマートフォンのディスプレイに利用されるようになった有機ELについて、材料とデバイスに関する研究開発動向を当研究室の研究内容と共に解説する。

主催：AREC・Fiiプラザ／一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター 共催：公益財団法人長野県テクノ財団 浅間テクノポリス地域センター

●お申込先 AREC・Fiiプラザ事務局 宛

メール (mousikomi@arecplaza.jp) またはファックス (0268-21-4382) でお申し込みください。

AREC・Fiiプラザ 第156回リレー講演会 参加申込書		(平成26年5月22日)	
企業・機関名			
参加者名			
所属・役職	電話番号		
メールアドレス	ファックス番号		

※ご記入いただいた個人情報(御社名、所属・役職、氏名)は受付名簿としてのみ使用し、他の用途には一切利用いたしません